

2026 年 9 月 28 日

对中国武汉市三选科技有限公司 及其销售产品的两家台湾代理商 提起芯片背面保护胶带的专利侵权诉讼

2026 年 9 月 17 日，琳得科向台湾新北市的知识产权及商业法院，对分别位于中国的芯片背面保护胶带制造商——武汉市三选科技有限公司（以下称“三选科技公司”），以及销售其产品的台湾代理商——热力应用材料有限公司与研展科技股份有限公司提起专利侵权诉讼，请求停止制造及销售等（以下称“本案诉讼”）。

本公司认为，三选科技公司所制造的芯片背面保护胶带，侵害了本公司所拥有的芯片背面保护胶带相关台湾专利第 I516530 号、第 I634187 号、第 I833953 号及第 I542659 号专利权（以下称“本案专利”），进而提起本案诉讼。

本案专利涉及应用于 Wafer Level Chip Scale Package (WLCSP) 的重要技术，截至 2026 年 6 月，本公司在包括台湾、中国、韩国、菲律宾及新加坡在内的 8 个国家及区域，累计拥有与芯片背面保护胶带相关的专利 600 件以上。本案诉讼中，三选科技公司涉嫌侵权的产品如下：

- CTB-EV6
- CTB-EV6X2
- CWB-SEHW
- CTD-EK1225
- CTD-EK0825
- CTB-EV6R-HT

本公司致力于通过开发满足客户需求的独创产品来提升企业价值，并将知识产权视为重要的经营资源。本公司基于以下方针推动知识产权活动，本案诉讼亦为该活动的一环：

- 在基础事业领域及发展中事业领域构建专利组合
- 尊重其他公司的知识产权
- 采取包含对侵害本公司知识产权的第三方行使权利在内的适当措施

本公司将密切关注本案诉讼的进展，并视需要考虑进一步行使权利，例如对其他专利侵权行为提起诉讼等。